

ams OSRAM tritt der von Credo geführten OCP-Initiative zur Standardisierung von Short-Reach Micro-Emitter Optics bei

Brancheninitiative vereint Hyperscaler und führende Unternehmen der Photonik-Branche, um latenzarme und kosteneffiziente optische Interconnect-Lösungen für AI Scale-up- und Scale-out-Netzwerke zu entwickeln.

- Mit der Teilnahme an der Initiative „Short-Reach Micro-Emitter Optics (SRMO)“ innerhalb des Open Compute Project (OCP) positioniert sich ams OSRAM in einer führenden Industrieallianz, die Standards für optische Konnektivität in KI-Infrastrukturen der nächsten Generation definiert
- Die Technologien von ams OSRAM in den Bereichen microLEDs, microVCSELs und microPhotodiodes schaffen die Grundlage für leistungsfähige und skalierbare optische Interconnect-Lösungen der nächsten Generation
- Optische Interconnects sind ein zentraler Baustein der Digital Photonics-Strategie von ams OSRAM und bieten attraktive Wachstumschancen im Bereich KI-Infrastruktur

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. Oktober 2026) – ams OSRAM tritt der von Credo geführten OCP-Initiative Short-Reach Micro-Emitter Optics zur Standardisierung hochparalleler optischer AI-Interconnects bei

ams OSRAM beteiligt sich an der Brancheninitiative „Short-Reach Micro-Emitter Optics (SRMO)“, die innerhalb des Open Compute Project (OCP) Industriestandards für eine neue Generation hoch performanter Data-Center-Interconnects entwickelt. Die vom US-Unternehmen Credo initiierte Branchenallianz vereint Hyperscaler und führende Technologieunternehmen entlang der gesamten optischen Wertschöpfungskette. Gemeinsam entwickeln sie Industriestandards für interoperable, hochparallele optische Konnektivität und schaffen damit die Grundlage für die nächste Generation von KI-Infrastrukturen.

Mit dem weiteren Ausbau von AI-Fabrics und GPU-Clustern steigt der Bedarf an Konnektivität erheblich, während gleichzeitig die für eng gekoppelte Rechenprozesse erforderlichen niedrigen Latenzzeiten gewährleistet werden müssen. Dadurch wächst die Nachfrage nach neuen Interconnect-Architekturen, die die Reichweite optischer Verbindungen mit den Kosten- und Latenzeigenschaften klassischer Kupferverbindungen vereinen.

Der sogenannte „Wide-and-Slow“-Ansatz begegnet dieser Herausforderung, indem Daten über eine Vielzahl paralleler optischer Kanäle mit optimierten Datenraten pro Kanal übertragen werden. Ziel ist es, die Reichweite optischer Technologien mit der Kosteneffizienz und der Latenz von kupferbasierten Interconnects zu verbinden und gleichzeitig Energie- sowie Thermaleffizienz weiter zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter von Micro-Emittern ist ams OSRAM hervorragend positioniert, diese Technologie zur Marktreife zu bringen und die künftigen Anforderungen bei Scale-up-Interconnects zu adressieren.

Auf der ECOC 2026 unterstrich ams OSRAM seine Technologieführerschaft bei Lichtemitter-Technologien mit der Vorstellung einer neuen 850-nm-Dünnschicht-VCSEL-Plattform für Wide-and-Slow Optical Interconnects sowie der Präsentation einer steckbaren Multicore-Fiber-Lösung gemeinsam mit Ökosystempartner BizLink. Aufbauend auf diesen Entwicklungen adressiert die

SRMO-Initiative den Marktbedarf nach interoperablen Interconnect-Lösungen. Die zugrunde liegenden hochparallelen Micro-Emitter-Technologien ermöglichen neue Formfaktoren für sich schnell entwickelnde Scale-up- und Scale-out-Infrastrukturen in KI-Rechenzentren.

Die gemeinsame Spezifikation, deren OCP-Freigabe für 2027 angestrebt wird, wird Anforderungen an Signalübertragung, Energieeffizienz, Formfaktoren sowie Modul- und Steckerschnittstellen definieren.

„KI-Infrastrukturen der nächsten Generation erfordern die Reichweite optischer Verbindungen, ohne die traditionellen Kosten- und Latenznachteile hochperformanter optischer Links in Kauf nehmen zu müssen“, sagte Ashkan Seyed, Vice President und General Manager of Digital Photonics Interconnect bei ams OSRAM. „Wide-and-Slow-Micro-Emitter und Micro-Receiver ermöglichen im Vergleich zu Kupfer eine 20- bis 30-fach größere Reichweite und bieten gleichzeitig eine gleichwertige Bandbreitendichte sowie Energie- und Kosteneffizienz. Mit unserem Engagement in der SRMO-Initiative tragen wir dazu bei das notwendige Ökosystem aufzubauen, um die auf der ECOC demonstrierte Technologie in interoperable und skalierbare Serienlösungen zu überführen.“

„Die hochparallele Micro-Emitter Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für KI Rechenzentrum-Fabrics und gemeinsame, interoperable Spezifikationen werden dem Ökosystem helfen, dieses Potenzial zu erschließen“, sagte L.K. Bhupathi, Associate Vice President of Product bei Credo. „Mit der SRMO-Initiative freut sich Credo darauf, gemeinsam mit den Branchenpartnern Spezifikationen zu definieren, die eine resiliente Lieferkette, eine schnellere Einführung der Technologie und kontinuierliche Innovation fördern.“

ams OSRAM plant, einen Beitrag zum entstehenden SRMO-Framework zu leisten und dabei sein Technologieportfolio einzubringen. Dies umfasst adressierbare 2D-microLED- und microVCSEL-Emitterarrays, passende microPhotodiode-Empfängerarrays, CMOS-Kompetenzen sowie fortschrittliche 3D-Packaging-Technologien.

Die 850-nm-Plattform des Unternehmens basiert auf dem kosteneffizienten GaAs-Materialsystem und ist mit der weit verbreiteten OM3-Multimodefaser-Infrastruktur kompatibel. Je nach Anwendungsanforderung unterstützt die Plattform sowohl microLED-basierte Short-Reach-Verbindungen als auch microVCSEL-basierte Verbindungen mit größerer Reichweite.

Die Beteiligung am OCP-SRMO-Framework unterstützt die Digital Photonics-Strategie von ams OSRAM und die Ambition des Unternehmens, neue Chancen im Bereich KI-Infrastruktur mit differenzierten Optical-Interconnect-Technologien zu adressieren. Optical Interconnects für KI-Rechenzentren zählen dabei zu den wichtigsten Wachstumsfeldern des Unternehmens – neben hochauflösenden Automotive-Lichtsystemen, Micro-Emitter-Projektionsarrays für AR Smart Glasses sowie fortschrittlichen optischen Sensorlösungen.

Weiterführende Informationen zu Optical Interconnects sowie zur KI-Photoniktechnologie von ams OSRAM stehen auf der [Technologieseite](#) des Unternehmens zur Verfügung.

Weiterführende Informationen zur Short-Reach Micro-Emitter Optics (SRMO) Initiative des Open Compute Project (OCP) finden Sie in der [Ankündigung](#) von Credo sowie auf der [SRMO-Projektseite](#).

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

Mehr über uns erfahren Sie auf <https://ams-osram.com>

ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM auf Social Media folgen: [>LinkedIn](#) [>YouTube](#)

Für weitere Informationen

Investor Relations
ams-OSRAM AG
Dr. Jürgen Rebel
Senior Vice President
Investor Relations
T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com

Media Relations
ams-OSRAM AG
Bernd Hops
Senior Vice President
Corporate Communications
T: +43 3136 500-0
press@ams-osram.com